



NUMBER 178306

METRIC

PRINT DIST DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

AMP-1 REV.10/83

VIEW A
回路番号
CIRCUIT NO
AMPマーク
シリーズマーク
SERIES MARK

タブコンタクト
TAB CONTACT
リテンションレグ
RETENTION LEG
コンタクト半田付部
CONTACT TAIL

コネクタ外形
OUTLINE OF HEADER HOUSING
DIA 1.1 ± 0.1 12 PLACES
スルーホール 2-φ3
DIA 3 ± 0.1 2 PLACES
ラウンド 2-φ4 MIN
ROUND DIA 4 MIN 2 PLACES

推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6 ± 0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL-HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED
- FINISH (CONTACT TAIL): OVER-NICKEL
- FINISH (CONTACT TAIL): TIN PLATED
- FINISH (CONTACT TAIL): OVER NICKEL

注 記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
膜厚: 0.38 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
膜厚: 0.76 μm MIN 金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
膜厚: 2.0 μm MIN スズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

△	△	178306-5
△	△	178306-3
△	△	178306-2
(FINISH)		部品番号 (PART NO.)

Copyright © 1995 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
B1	REVISED ECR-07-013273	T S D H	10007	12 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100	
B	REVISED(FJ00-0039-03)	T S S M	4/2	-	
A	REVISED(FJ00-0114-03)	T S S H	25.APR	-	
O	RELEASED FJ00-2528-95	N M Y I	6/30	-	
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	CHK
				Y. ISHIKAWA	S. MANABE

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面